

TM700 / TN700

LTE Cat.4 Embedded Module Brief Specification Sheet



TM700



TN700

LTE Cat.4

Qualcomm MDM9207

VoLTE 지원

Compact Form Factors

Product Overview

TELADIN TM700 및 TN700은 Qualcomm MDM9207 메인 칩셋을 적용한 LTE Cat.4 임베디드 모듈 시리즈입니다. 국내 이동통신 3사(KT / LG U+ / SKT) 망을 지원하며, 차량 관제·관제 서버 연동 등 안정적인 광대역 IoT 통신이 요구되는 산업용 애플리케이션에 최적화되어 있습니다. 초소형 LCC 타입(TM700)과 표준 M.2 타입(TN700)으로 제공됩니다.

Key Features

Optimized LTE Cat.4 Connectivity

하향 최대 150 Mbps, 상향 최대 50 Mbps 속도를 지원하여 대용량 스트리밍 및 고해상도 이미지 전송에 최적의 대역폭을 제공합니다.

Crystal Clear VoLTE Voice Support

고음질 음성 통화(VoLTE) 코덱을 완벽히 지원하여, 긴급 비상 인터콤, 엘리베이터 통신 등 데이터와 음성 제어가 동시에 요구되는 시스템에 뛰어난 호환성을 자랑합니다

Multiple Form Factor Flexibility

공간 제약이 심한 소형 장치용 LCC (TM700)과 표준 M.2 타입(TN700)을 동시 제공하여 하드웨어 설계 유연성을 극대화합니다.

Rich Hardware Interfaces

UART, USB 2.0 High Speed 인터페이스와 외장 안테나 패드를 기본 내장하여 다양한 산업용 IoT 센서 모듈과의 연동 및 데이터 수집 아키텍처 확장이 용이합니다.

Technical Specifications

구분 (Specifications)	TM700 (LCC Type)	TN700 (M.2 Type)
Target Market / Network	Korea (KT / LG U+ / SKT 망 인증)	Korea (KT / LG U+ / SKT 망 인증)
Baseband Chipset	Qualcomm MDM9207	Qualcomm MDM9207
Standard	LTE Cat.4 / GPS	LTE Cat.4 / GPS
Frequency Bands	B1 / B3 / B5 / B8	B1 / B3 / B5 / B8
Data Rates	150 Mbps DL / 50 Mbps UL	150 Mbps DL / 50 Mbps UL
Memory	2 Gb SLC NAND + 2 Gb LPDDR2	2 Gb SLC NAND + 2 Gb LPDDR2
RF Rx Sensitivity	≤ -104 dBm (FER 0.5%)	≤ -104 dBm (FER 0.5%)
Hardware Interfaces	USIM, UART, USB 2.0 High Speed	USIM, UART, USB 2.0 High Speed
Voice	VoLTE 지원	VoLTE 지원
Data / SMS	지원	지원
Power Supply	3.3~4.2 VDC	3.3~4.2 VDC
Power Consumption	Max 1000 mA / Avg 300 mA / Sleep 2 mA	Max 1000 mA / Avg 300 mA / Sleep 2 mA
Pinout & Package	143-pin LCC Type	75-pin M.2 Type
Physical Dimensions	32.0 × 29.0 × 2.4 mm	30.0 × 42.0 × 3.0 mm
Weight	5.0 g	5.2 g